

Tescan Uni TOM HR 二代



原位 Micro-CT：半导体深埋结构无损检测

- 分析半导体封装的热诱发位移
- 全方位三维表征内部形变机制
- 支持先进高密度器件的可靠性分析
- 揭示超越表面检测方法的结构变化



Tescan FemtoChisel™



集成式激光加工技术：半导体失效分析

- 借助洁净超快激光加工，快速显露内部隐蔽结构
- 保障异质半导体封装器件的表面完整性
- 结合 CT、扫描电镜与光学成像，提升定位精准度
- 减少后续聚焦离子束抛光工作量，加快高分辨最终分析



Tescan SOLARIS X 二代



FIB-SEM：实时 SEM 观测样品制备

- 对复杂集成电路封装完成洁净大面积截面切割
- 采用 TRUE X-sectioning（硅挡板技术）与摇摆样品台，改善窗帘效应
- 借助扫描电镜观测与实时终点探测，辅助失效定位
- 检出关键界面、分层缺陷及隐蔽失效点位
- 衔接封装级制样与最终高分辨分析



Tescan TENSOR



稳健 4D-STEM 分析：工艺研发

- 联用扫透电镜、4D-STEM 与能谱分析，表征先进半导体器件
- 快速完成物相、取向、应变及成分分析
- 发现传统成像无法识别的结构差异
- 自动化流程保障测量结果稳定、可复现
- 助力工艺快速优化与新一代器件可靠性验证